

2024年領航基金 PGIM保德信科技島基金

聚焦高純度AI供應鏈

2024年7月

保德信投信獨立經營管理。

保德信及其岩石商標為專有服務標誌，未經本公司事先同意前，不得使用。



大綱

市場展望

基金投資流程

基金特色優勢

市場展望

四大投資亮點

2024年台灣科技股機會



美國科技股續強 台廠供應鏈續旺

- AI熱潮為美國科技帶為強動能，2023年以來台灣電子產業推升台灣加權指數屢創新高，在全球終端需求逐步發酵的態勢下，產業機會將加速放大。

AI燒不退 半導體市場規模急升

- 市場預估2032年前，全球半導體產業規模將以14.9%雙位數複合年增幅高速擴張，需求帶動的爆量訂單量將使台廠供應鏈直接受惠。

庫存去化告終 晶圓代工重返成長軌道

- 全球晶圓代工獲利重返成長軌道，其中台廠在先進製程晶片拿下全球9成以上市占，預期其技術優勢將帶動整體台廠產業鏈競爭力。

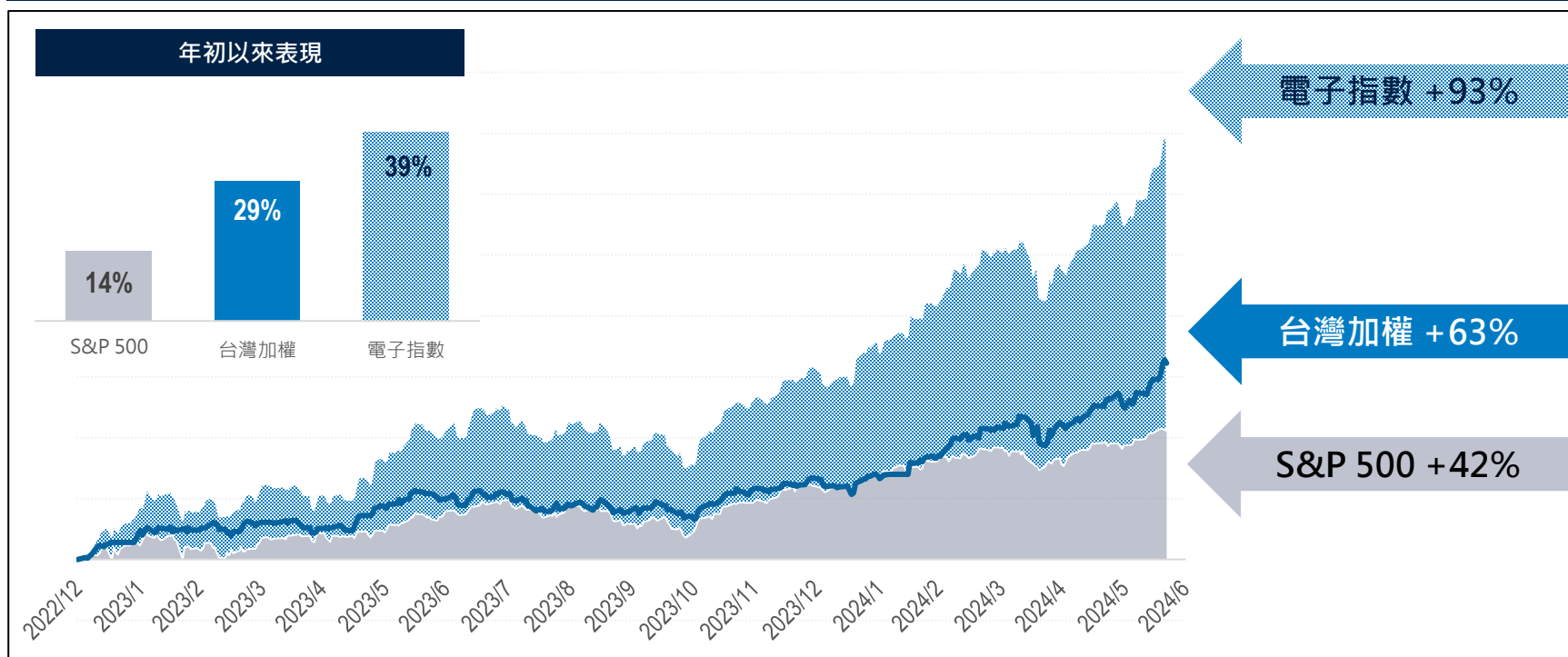
AI滲透終端電子 SEMI強勢撐台廠

- AI晶片帶動CoWoS先進封裝需求，隨龍頭大廠引領的AI晶片加速進入市場，相關終端電子需求將推升台廠持續上攻。

科技掌握全趨勢 推升台股齊力飆

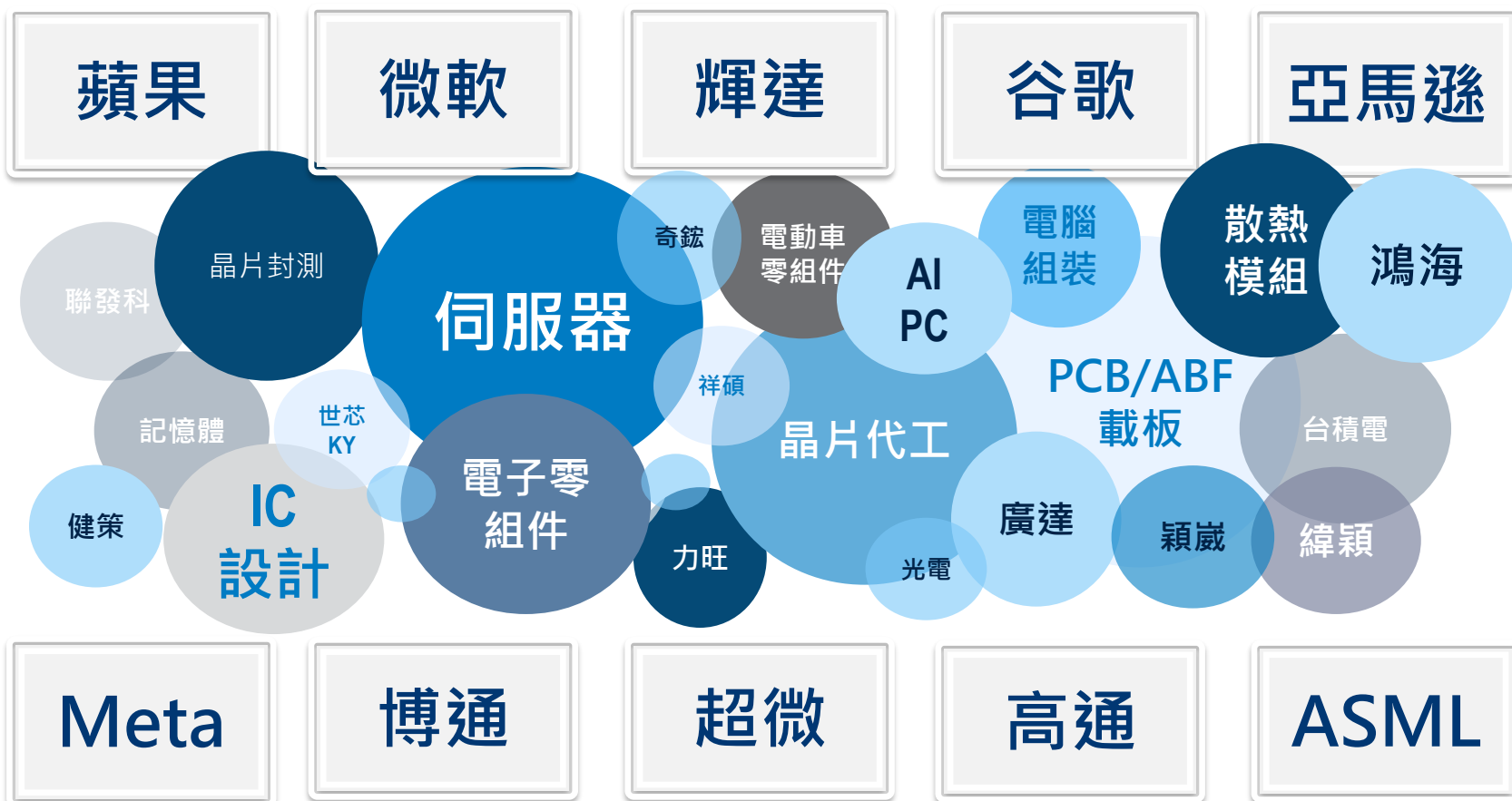
AI趨勢浪潮下，2023年以來台灣電子產業推升台灣加權指數屢創新高，衍生需求推動科技發展再創歷史輝煌新頁，預期在全球終端需求逐步發酵的態勢下，產業機會將加速放大。

2023年以來電子指數帶頭領漲



資料來源：Bloomberg，保德信投信整理，2022/12/31~2024/6/30。注意：本資料所示之指數及個股係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為保德信投信所管理基金之對比指數或投資之標的。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

全球科技龍頭帶動台廠供應鏈訂單大放量

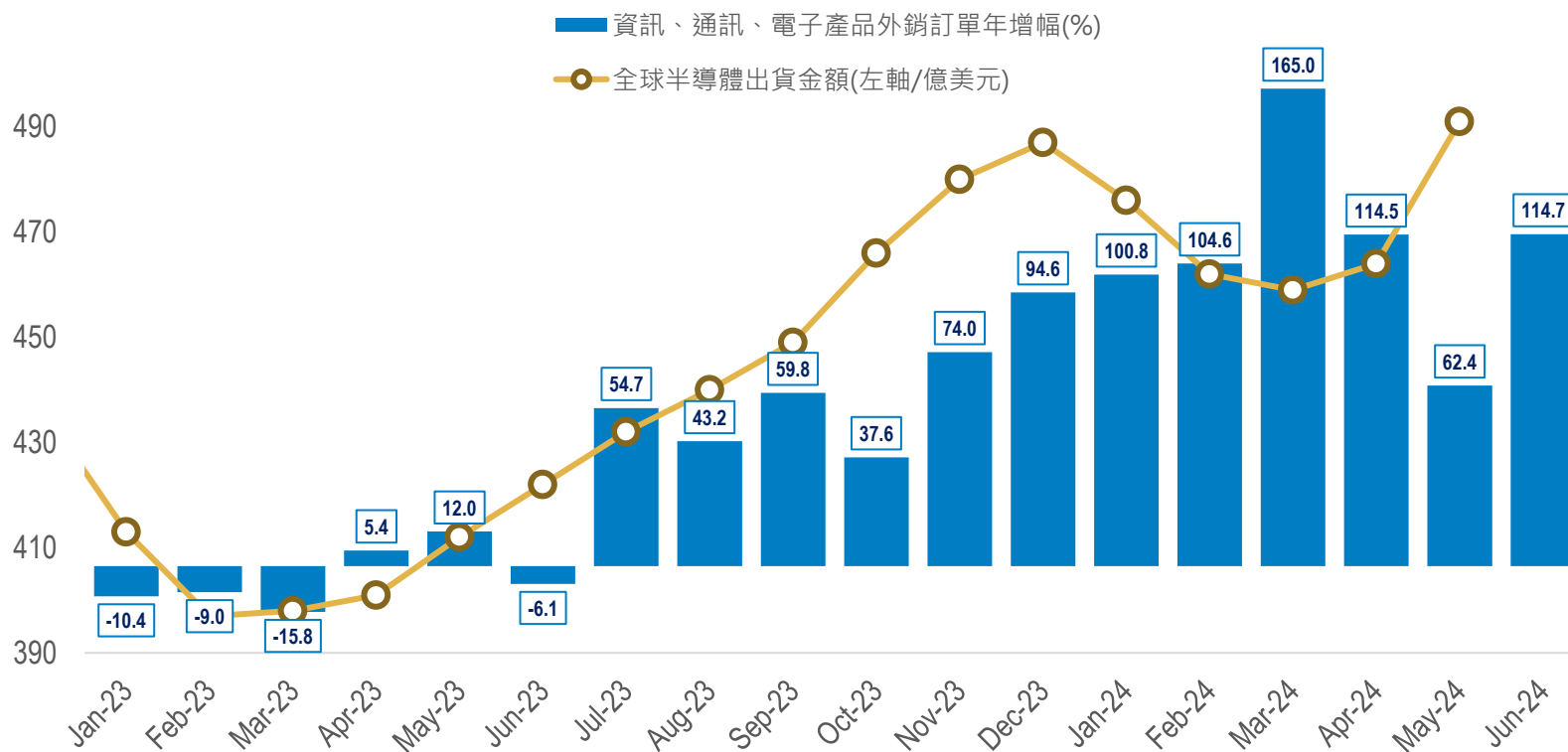


注意：本資料所示之指數及個股係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為保德信投信所管理基金之對比指數或投資之標的。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

全球科技股續強 台廠供應鏈續旺

AI熱潮持續為美國科技帶來強動能，台廠在全球供應鏈中的地位愈發重要。訂單滿載將加速推升企業獲利，台廠亦將憑藉節節攀升的科技產業地位，持續強化企業的價格強勢主導性。

全球半導體需求帶動台廠供應鏈訂單大放量



資料來源: macromicro, 保德信投信整理 · 2024/7/23。

半導體產值大爆量 台廠營收佔比拿7成

市場預估2032年前，全球半導體產業規模將以14.9%雙位數複合年增幅高速擴張，需求帶動的爆量訂單量將使位居全球晶圓代工市佔龍頭的台廠與其供應鏈直接受惠。

全球半導體產值 (單位: 億美元)



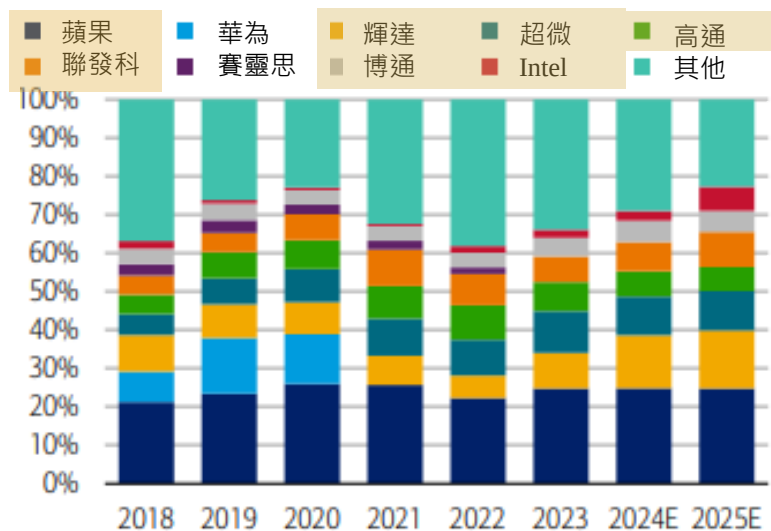
2024年全球晶圓代工 營收佔比預估	台灣	南韓	中國	美國	其他
	70%	11%	8%	7%	4%

晶圓代工扛壩子 動能推升供應鏈

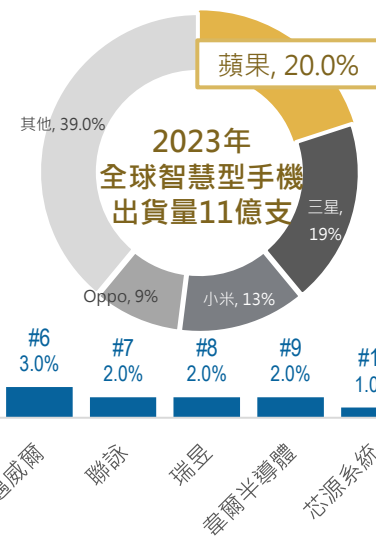
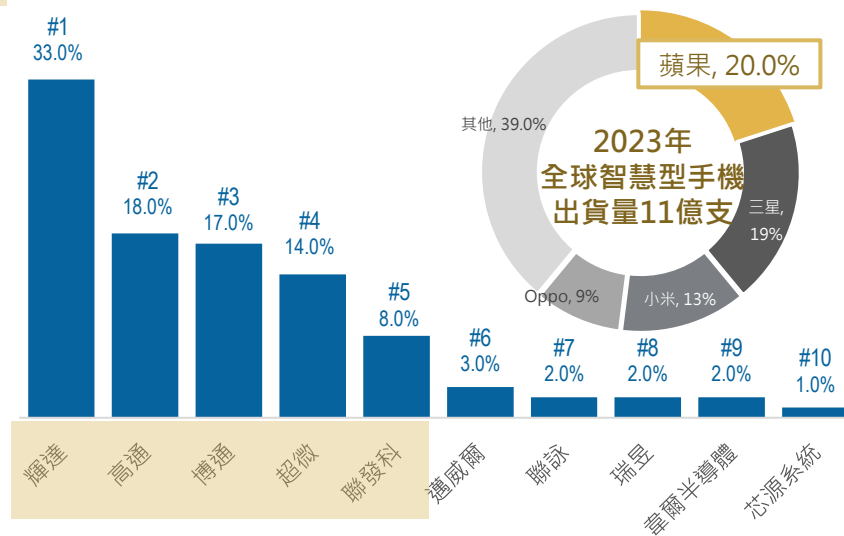
- 台灣晶圓代工大廠主要營收來源高達近8成來自於全球科技龍頭企業，其中3奈米、5奈米先進製程晶片更拿下全球9成以上市占，預期其技術優勢將帶動整體台廠產業鏈競爭力。

全球科技龍頭廠占台積電營收近8成

台灣晶圓代工龍頭廠主要營收來源占比



全球IC設計龍頭廠2024年市占排名

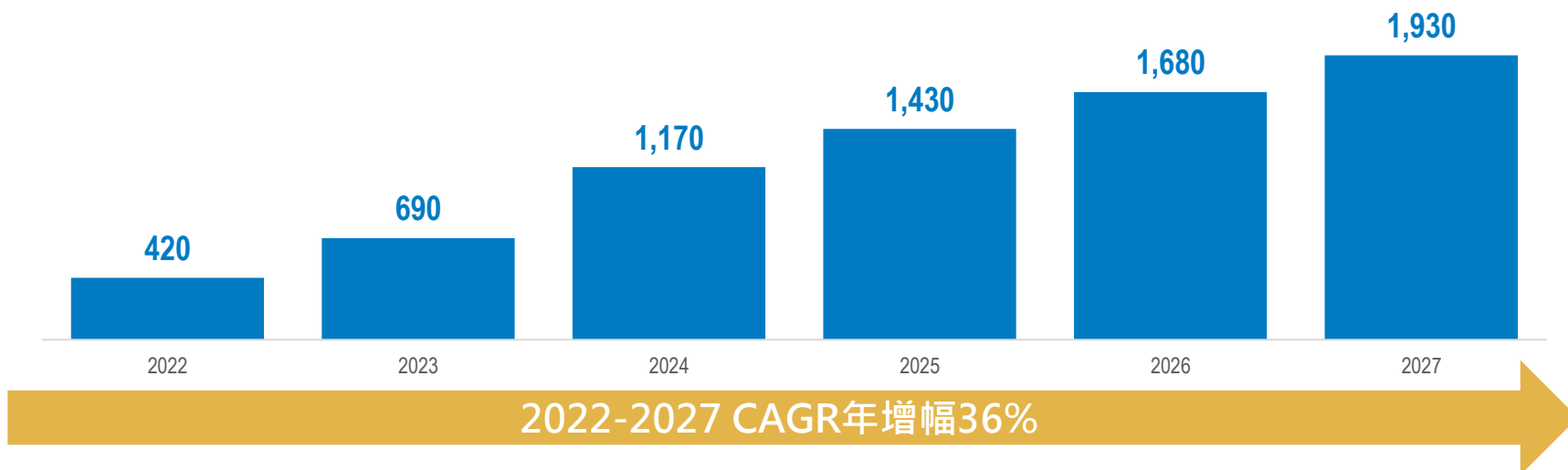


資料來源：左圖 - BofA Global Research，2024/6/11；右圖 - Trendforce, IC設計2023全年營收占比，2024/5/9；圓餅圖：IDC，2024/1/15，保德信投信整理。注意：本資料所示之指數及個股係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為保德信投信所管理基金之對比指數或投資之標的。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

AI軍備競賽潮來襲 強化雲端基建是王道

- ✓ 資料中心涉及的業務範圍，包括透過機房內的AI伺服器來提升AI演算法的執行速度和精準度，同時強化AI系統整體穩定性，來放大AI效能，因此各科技龍頭大廠不僅正搶佔AI市場，同時也正加速鋪天蓋地的強化基礎建設的覆蓋率。
- ✓ 初估AI資料中心基建支出在2027年前，將以近36%的複合年增幅高速成長，其相關資本支出可望由2022年的420億美元，提升至2027年的1,930億美元。

半導體AI資料中心基建支出(單位: 億美元)



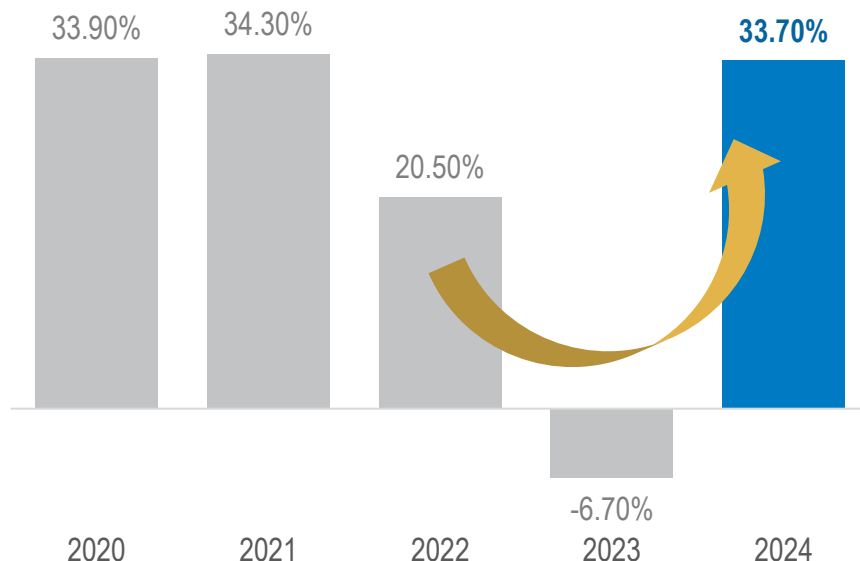
資料來源：Bloomberg Intelligence，2024/6/18，保德信投信整理，2024/6/24。

雲端市佔相爭 台廠代工得利

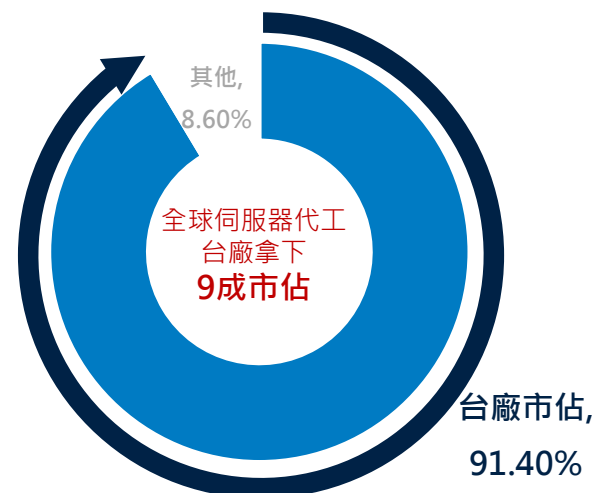
- ✓ 強勁需求支撐四大雲端供應商大幅提升全年資本支出達3成以上，以加速擴大市場版圖。
- ✓ 拿下全球 9 成市佔的台廠伺服器代工產能將再顯神威！

伺服器需求不減 台廠ODM直接受惠

四大雲端大廠資本支出 %



2023年全球伺服器代工市佔 %



資料來源：左圖 - Bloomberg, 國泰證期研究部, 兆豐國際, 2024/5, 保德信投信整理；右圖 - MIC, 2024/1, 保德信投信整理。四大雲端供應商: Google、亞馬遜、Meta、微軟。注意：本資料所示之指數及個股係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為保德信投信所管理基金之對比指數或投資之標的。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

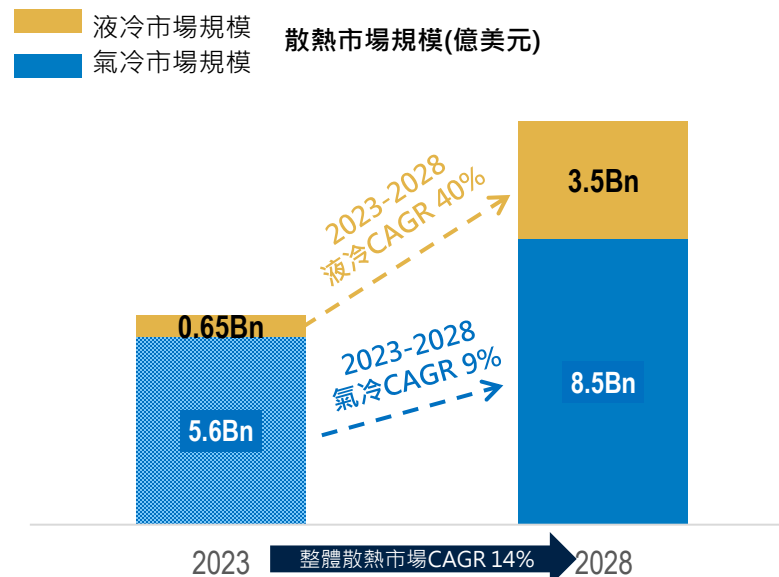
散熱架構趨轉型 應用效能再升級

- ✓ 電子產品朝向高精密、高效能的趨勢發展，再加上AI快速滲入終端電子應用，研究報告顯示，2023年全球散熱市場規模約達62.5億美元。
- ✓ 有鑑於電動車、資料中心、AI與伺服器帶動市場對於散熱模組的需求，預期散熱市場將以近14%的複合年成長率在2028年達到120億的規模邁進，而隨著散熱需求走向極致化，液冷市場規模將以40%的複合年成長率擴大。

散熱解決方案走向極致化將帶動價量齊揚

NV 晶片規格	功耗(W)	散熱解決方案	散熱單價
H100	700	3DVC	\$80-120
B100	700	3DVC	\$80-120
B200	1200	3DVC/ Cold Plate	\$80-120 / \$400
GH200	1000	Cold Plate	\$400-2000
GB200	1500	Cold Plate	\$400-2000

整體散熱市場將以年複合率14%擴張



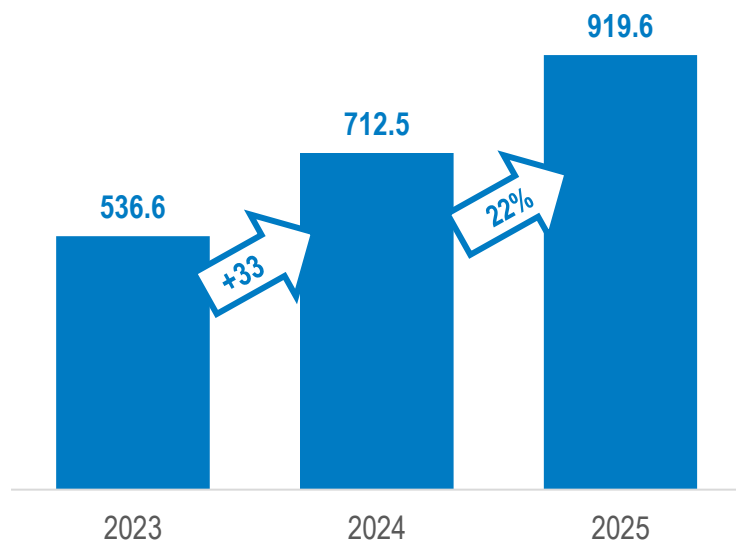
資料來源: 左圖-Masterlink，2024/3/5；右圖 - Bloomberg Intelligence, 2024/5/16，保德信投信整理。

AI帶動獲利彈升 晶片代工展望轉正

- ✓ 市調機構預期全年AI晶片獲利年增幅將上看3成。
- ✓ 在需求動能推升之下，今年全球晶圓代工獲利年增幅可望由去年的-12.5%，直線躍升至雙位數14.7%。

今年全球AI晶片獲利年增幅上看33%

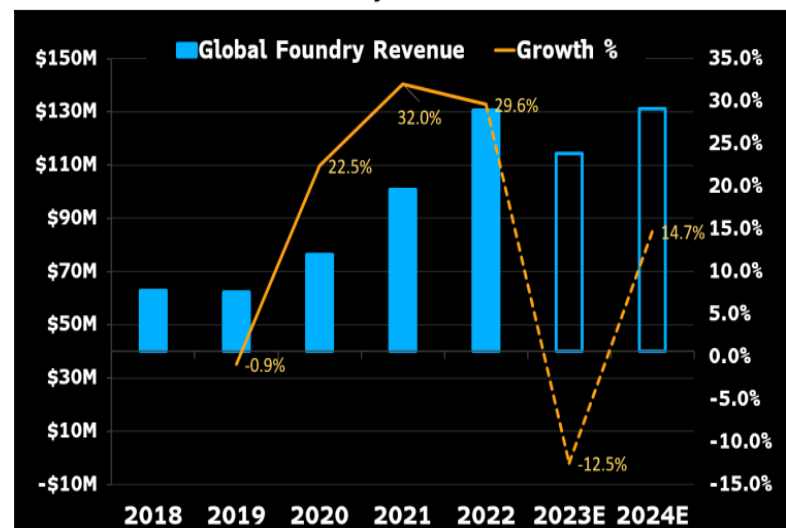
全球AI 晶片獲利 (單位: 億美元)



■ 全球AI 晶片獲利 (單位: 億美元)

全球晶圓代工獲利展望

Global Foundry Revenue Outlook



Source: Gartner, Bloomberg Intelligence

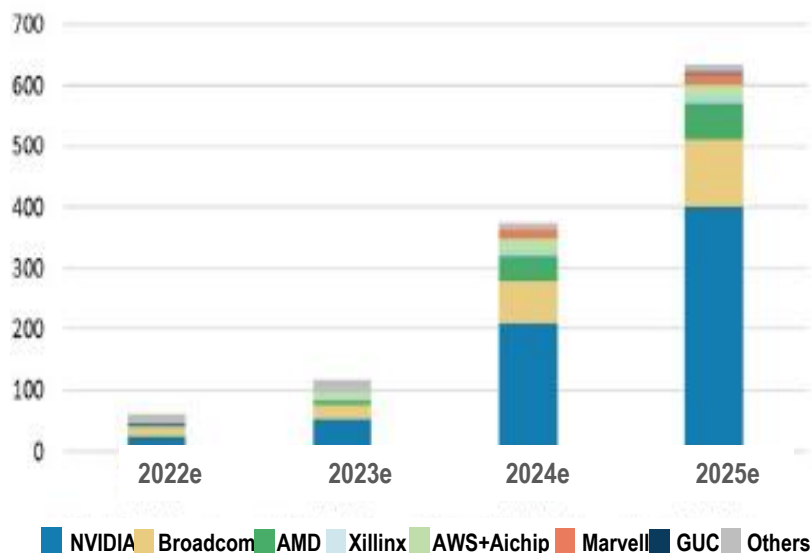
資料來源：左圖 - Gartner · 2024/5/29 · 保德信投信整理；右圖-Bloomberg Intelligence · 2024/3/5。

AI晶片攻市佔 封裝產能大爆量

- ✓ AI晶片帶動CoWoS先進封裝需求，透過晶片堆疊並封裝在基板上，並根據2.5D與3D排列的形式減少晶片的空間並強化AI效能，隨龍頭大廠引領的AI晶片加速進入市場，CoWoS產能將持續放大。
- ✓ 市場預估今年下半年有42萬顆GB200AI晶片進入下游市場，並初估GB200AI晶片產能在明年將上看150萬顆-200萬顆。

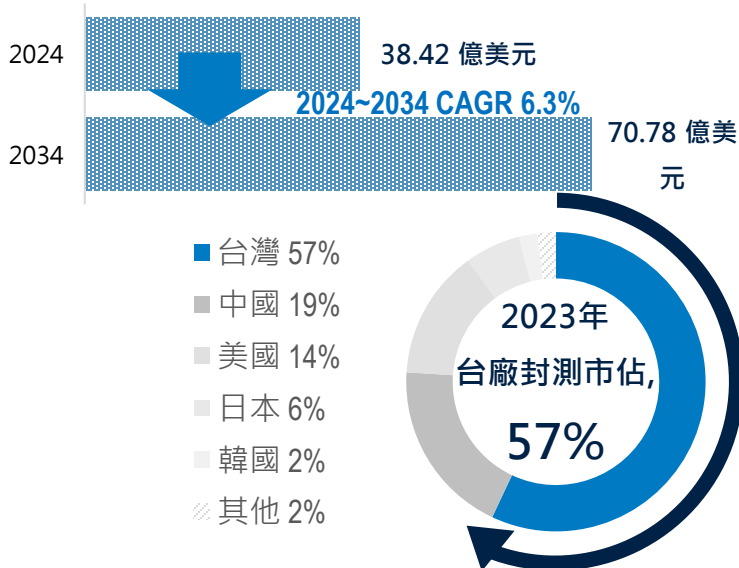
CoWoS先進封裝產能結構 (by客戶需求)

Global CoWoS capacity demand by key customer



全球IC封裝高速成長 台廠拿下近6成市佔

全球IC封測市場規模預估



資料來源：左圖-Morgan Stanley, 2024/6/19; 右上-Future Market Insight, 2024/3, 保德信投信整理; 右下-Bloomberg · 2024/6/21。

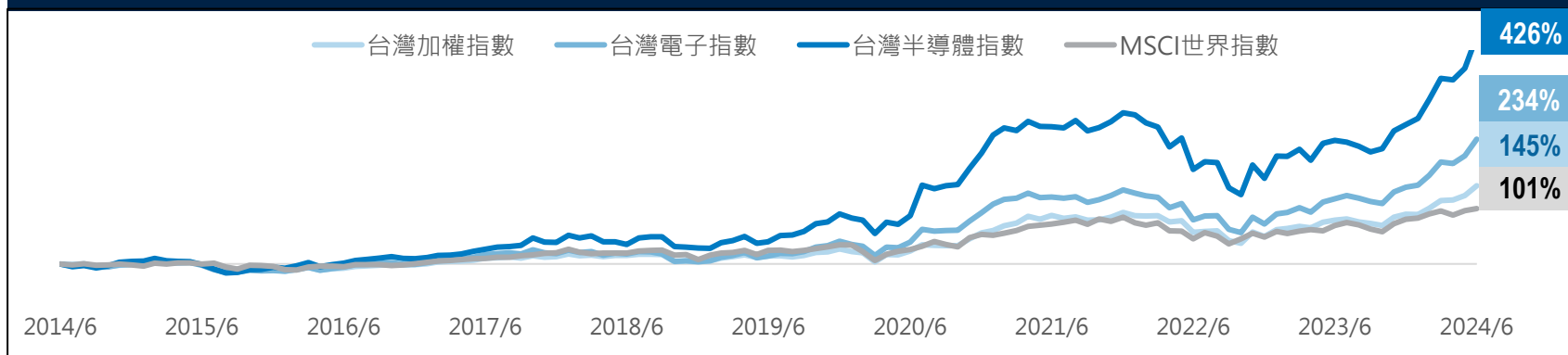
科技掌握全趨勢

SEMI隻手撐台股

2014~2023單年漲跌幅

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024YTD
半導體	MSCI世界	半導體	半導體	半導體	半導體	半導體	半導體	MSCI世界	電子類股	半導體
29.6%	-2.7%	16.8%	27.3%	-7.4%	48.4%	58.2%	24.2%	-19.5%	39.5%	48.3%
電子類股	台灣加權	電子類股	MSCI世界	台灣加權	電子類股	電子類股	台灣加權	台灣加權	半導體	電子類股
20.0%	-10.4%	12.8%	20.1%	-8.6%	36.0%	36.5%	23.7%	-22.4%	38.8%	38.8%
台灣加權	半導體	台灣加權	電子類股	MSCI世界	MSCI世界	台灣加權	電子類股	電子類股	台灣加權	台灣加權
8.1%	-10.4%	11.0%	19.4%	-10.4%	25.2%	22.8%	21.6%	-26.6%	26.8%	28.5%
MSCI世界	電子類股	MSCI世界	台灣加權	電子類股	台灣加權	MSCI世界	MSCI世界	半導體	MSCI世界	MSCI世界
2.9%	-11.5%	5.3%	15.0%	-12.1%	23.3%	14.1%	20.1%	-31.8%	22.1%	10.8%

近10年累積漲幅



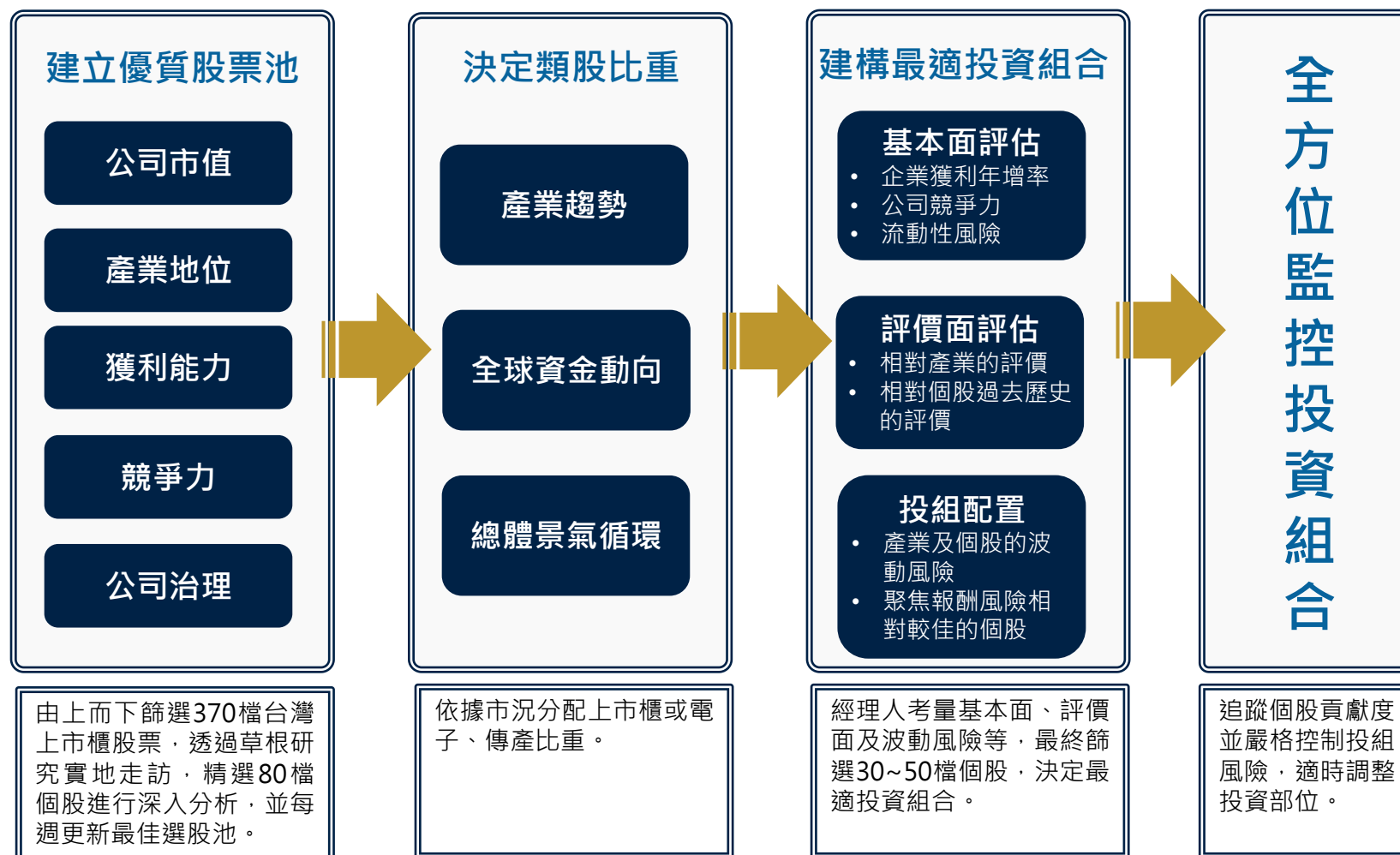
資料來源：Bloomberg，保德信投信整理，上表期間-2013/12/31~2024/6/30，下圖期間-2014/6/30~2024/6/30。

注意：本資料所示之指數及個股係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為保德信投信所管理基金之對比指數或投資之標的。

基金投資流程

基金投資流程

掌握科技趨勢 建構全方位投資組合



基金特色優勢

基金特色 | PGIM保德信科技島基金

掌握AI人工智慧商機

特色

Taiwan 強基底

全球經濟復甦直線回升為強健的台灣經濟體質與無懈可擊的企業競爭力注入堅實支撐。

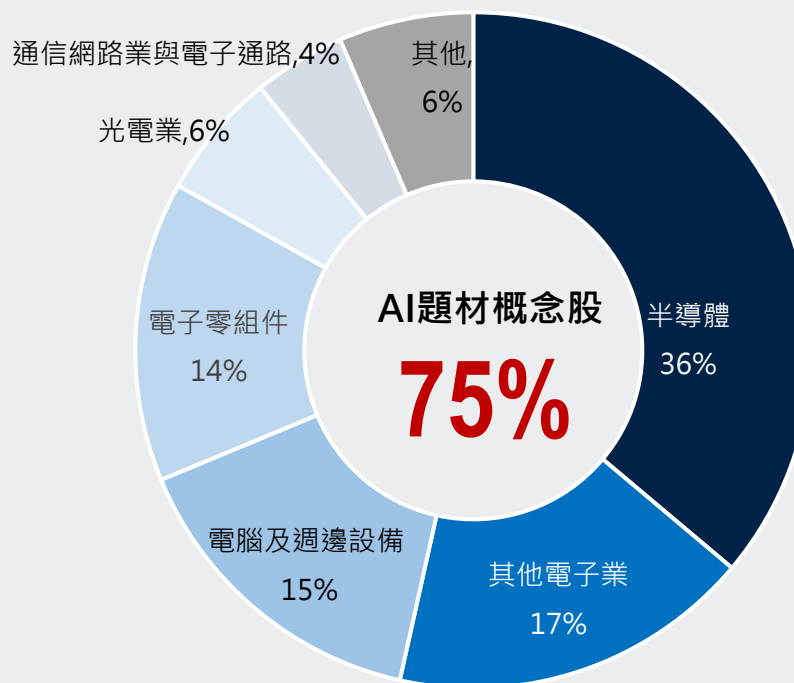
Essential 關鍵科技

聚焦全球關鍵科技上游產業，參與全球趨勢上游產業，榮享新核心經濟新頁。

Chips 完整供應鏈

洞悉半導體供應鏈趨勢，共享台灣半導體完整供應鏈穩守全球屹立不搖的產業地位。

PGIM保德信科技島持股比例



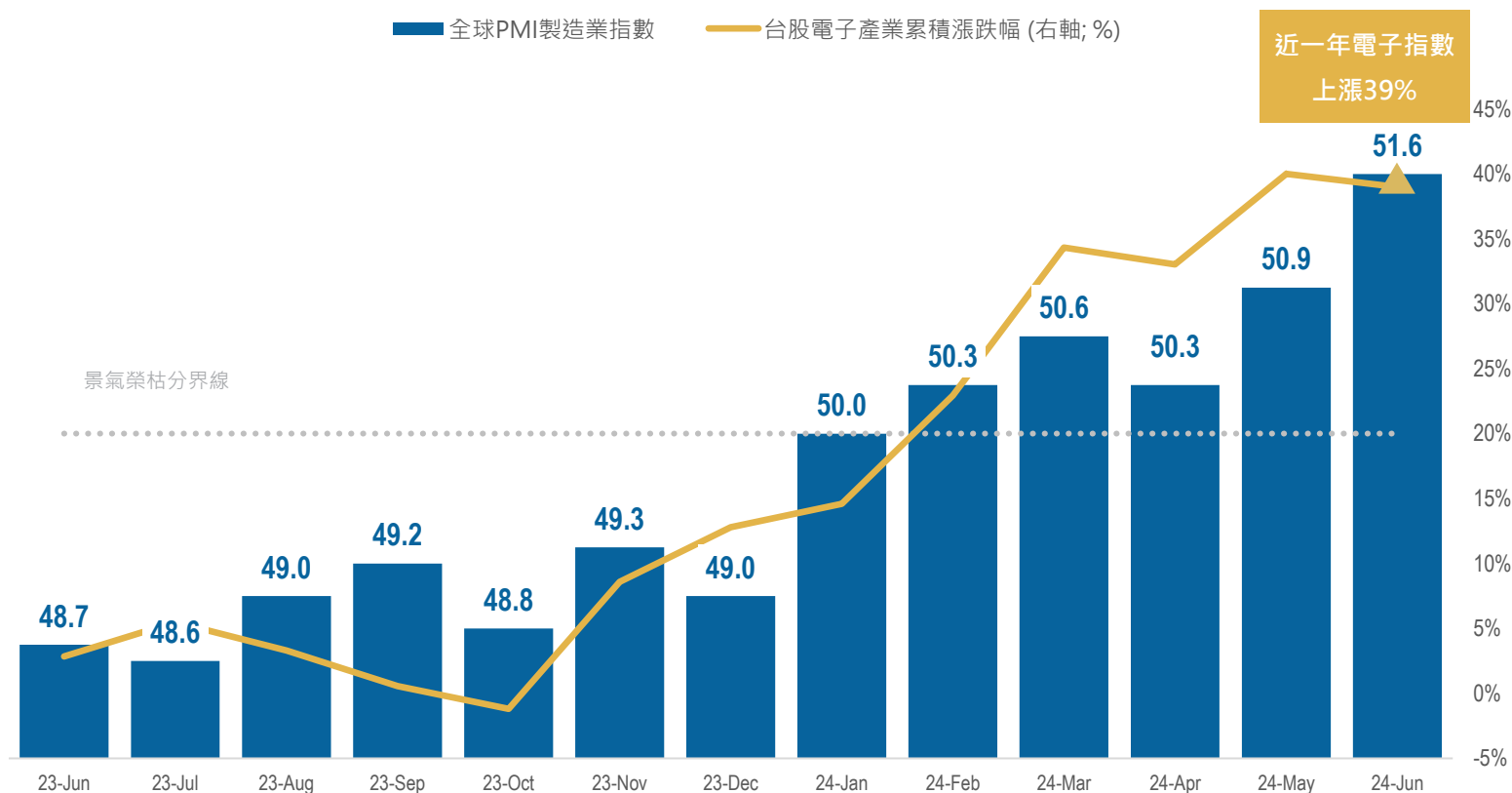
資料來源：基智網，保德信持股比例截至2024/7/19，保德信投信整理。

注意：本資料所示之指數及個股係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為保德信投信所管理基金之對比指數或投資之標的。

基金特色 | Taiwan 強基底

製造業動能回升 台灣科技股勢不可擋

台灣電子指數近一年漲幅達4成

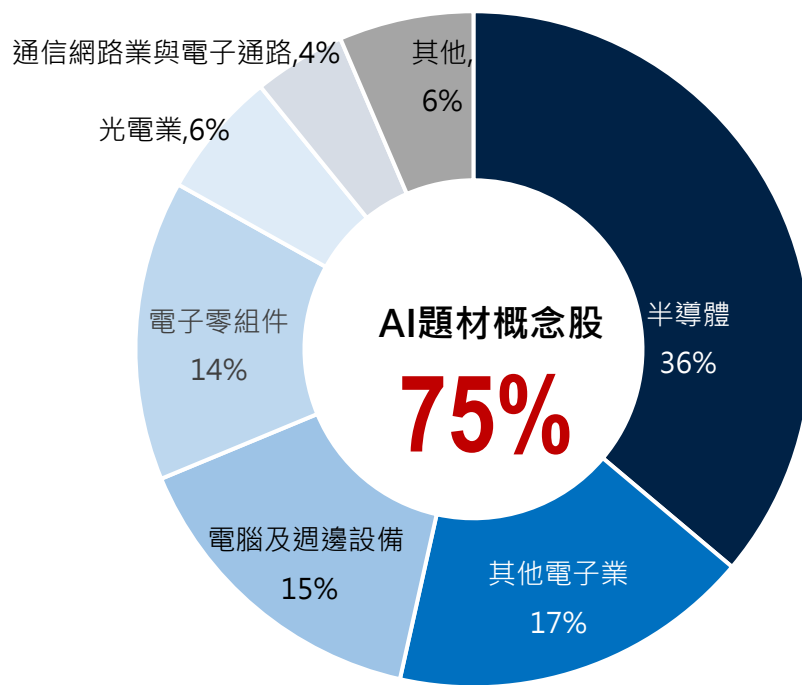


資料來源：Bloomberg，電子指數截至2024/6/30，保德信投信整理，2024/7/25。

注意：本資料所示之指數及個股係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為保德信投信所管理基金之對比指數或投資之標的。

基金特色 | Essential 關鍵供應鏈 聚焦科技主流趨勢

PGIM保德信科技島持股比例

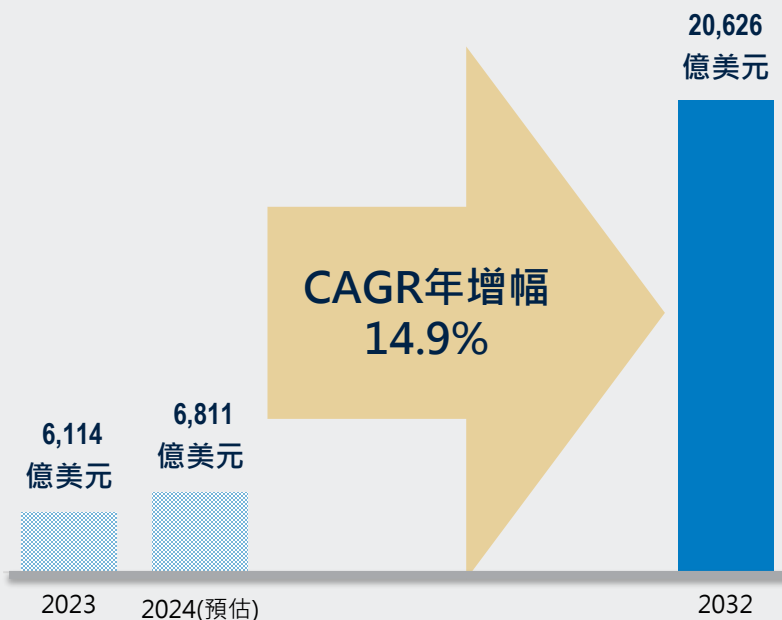


基金特色 | Chips

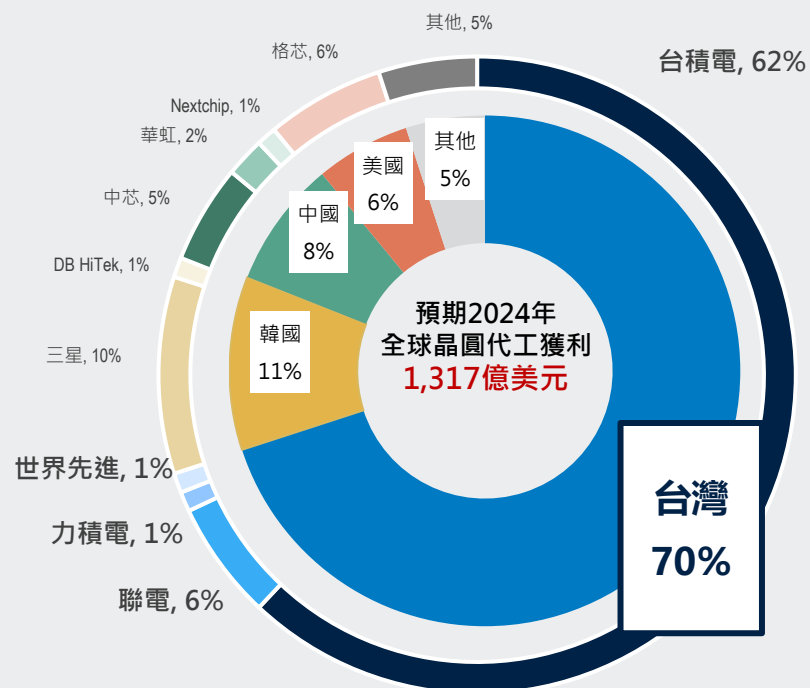
無可取代的先進製程技術

台灣晶圓代工No. 1

全球半導體產值 (單位: 億美元)



2024年台廠可望拿下全球晶圓代工7成獲利



資料來源：左圖- Fortune Business Insights, 2024/5/13；右圖：TrendForce，2024/2/23，保德信投信整理，2024/5/31。

注意：本資料所示之指數及個股係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為保德信投信所管理基金之對比指數或所投資之標的。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

掌握AI趨勢 盡在PGIM保德信科技島

PGIM保德信科技島基金前十大持股簡介

公司	相關領域	6/30權重	公司簡介
台積電	半導體-晶片代工	10.21%	全球晶片代工龍頭。
緯穎	電腦及週邊設備業-伺服器組裝	6.94%	電腦週邊、伺服器組裝ODM代工大廠。
鴻海	其他電子業-伺服器組裝	6.84%	專注於電子產品的代工服務與組裝。
奇鋐	電腦及週邊設備-散熱	6.42%	散熱模組大廠，強項為3D VC技術，應用於伺服器、網通產品等。
健策	電子零組-均熱片	5.90%	均熱片供應商，包括均熱片、LED導線架、伺服器連接扣件等。
元太	光電業-顯示器	4.80%	電子紙顯示器產品、顯示器技術: 全球電子紙領導廠商。
力成	半導體-晶片封測	4.07%	業務主力為記憶體積體電路之封裝測試業務，為全球前五大封測廠。
穎崙	半導體-晶片封測	3.66%	從事研究、製造及銷售半導體測試介面及配套產品。
智邦	通信網路業-網通晶片	3.41%	網通廠: 5G網通晶片
京鼎	半導體-設備	3.39%	半導體設備製造商，主要業務為半導體製程設備關鍵模組及零組件製造

結論

■ 投資亮點

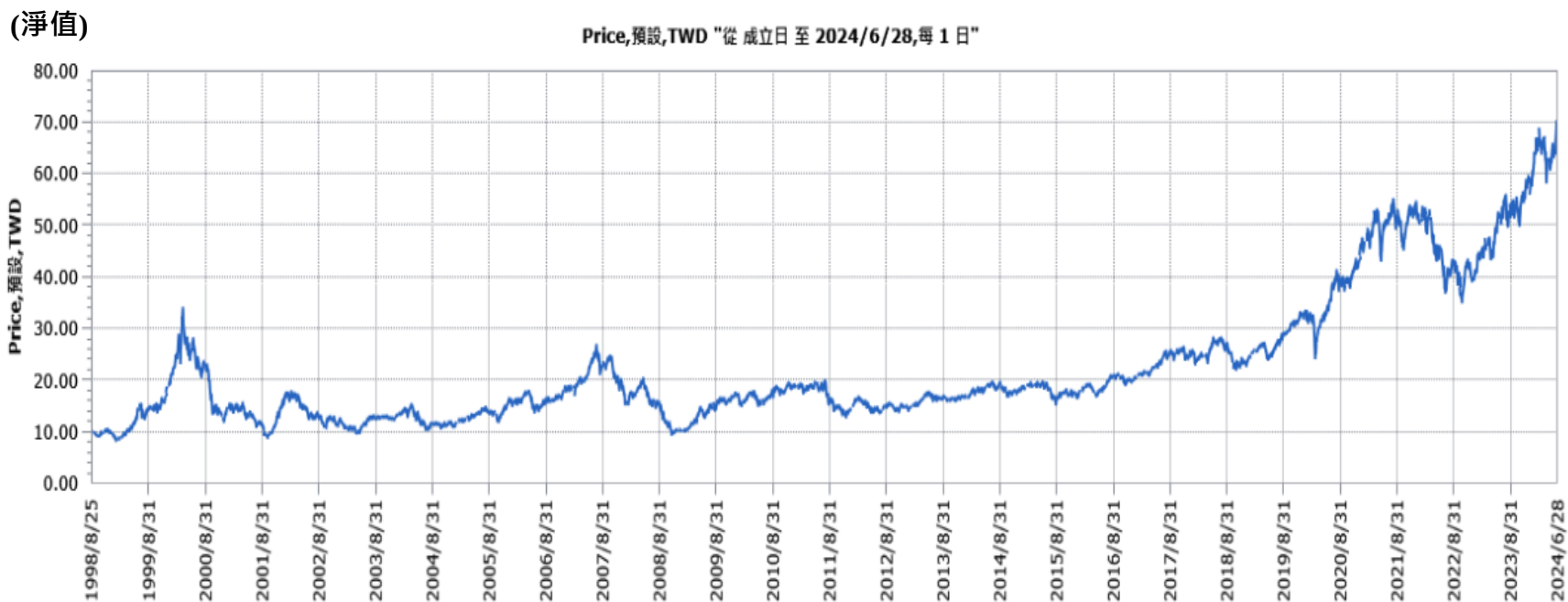
- AI熱潮為美國科技帶來強動能，訂單滿載將持續放大企業獲利，相關台廠半導體上、中、下游供應鏈將直接受惠，加上AI晶片帶動CoWoS先進封裝需求，隨龍頭大廠引領的AI晶片加速進入市場，相關終端電子需求將推升台廠產能火力全開。
- 終端消費電子庫存去化告終，全球晶圓代工動能重返成長軌道，台廠在先進製程晶片拿下全球9成以上市占，加上AI手機、AI PC嶄新登場，預期在相關終端電子需求帶動下，半導體產能將推升台廠持續上攻。

■ 基金操作策略

- **掌握關鍵科技供應鏈趨勢**：在生成式潮流帶動下，大型雲端及系統業者加大AI server相關支出，規格大幅提升有利於相關晶片供應鏈需求、零組件(ex: 散熱)、板卡及系統廠等可望受惠。
- **高度持有半導體、AI相關概念股**：目前半導體相關類股佈局達3成以上，AI題材概念股則高達7成以上；其中AI需求帶動的晶圓代工、伺服器、散熱與先進封裝將為主要佈局重點，此外，亦將增持零組件、IC設計等相關族群類股。
- **集中持股，靈活調整**：透過草根研究實地走訪，由精選80檔個股進行深入分析，最終將30~50檔最具競爭力的個股納入投組。

PGIM保德信科技島基金

PGIM保德信科技島基金成立以來淨值走勢



期間	3個月	6個月	1年	2年	3年	今年以來	成立以來
累積報酬率(%)	5.22	17.40	34.31	75.42	36.79	17.40	595.70

資料來源：Lipper，保德信投信整理，截至2024/6/28，以台幣報酬計算。過去之績效不代表未來績效之保證。

PGIM保德信科技島基金

基本資料

類別	股票型-投資國內-科技類
成立時間	1998/8/25
經理人	黃新迪*
彭博代碼	MSLHITI.TT

基金績效 (%)

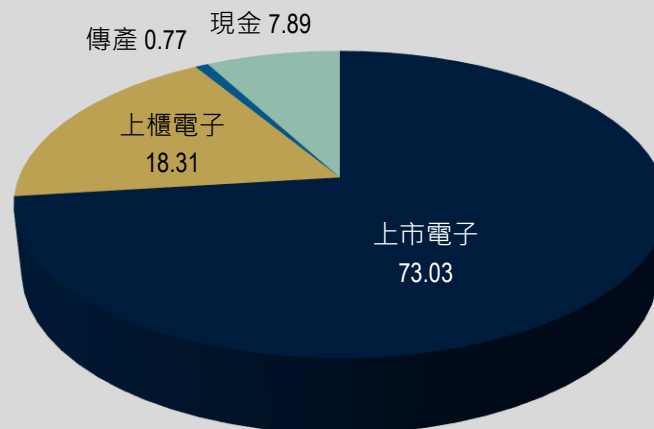
3個月	5.22
6個月	17.40
1年	34.31
2年	75.42
3年	36.79
5年	171.76
10年	264.43
今年以來	17.40
成立以來	595.70

基金特色

- 配合科技類股景氣循環，密切注意市場動態，以靈活管理基金投資組合
- 採Bottom-up 的選股方式，於上市、上櫃之科技類股尋找優質投資標的
- 以產業前景為優先考量因素，兼顧上市、上櫃科技股潛在成長契機

投資組合

基金規模：台幣24.41億元



(以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。)

基金績效和投資組合比重單位為%。資料來源：Lipper，分類標準為投信投顧公會、保德信投信。資料時間：2024/06/30。過去之績效不代表未來績效之保證。*
註：自2024年03月23日起接任。

保德信投信獨立經營管理 | 保德信及其岩石商標為專有服務標誌，未經本公司事先同意前，不得使用。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於本基金之公開說明書或投資人須知(境外基金適用)，投資人可至保德信投資理財網www.pgim.com.tw、公開資訊觀測站mops.twse.com.tw(境內基金適用)或境外基金觀測站announce.fundclear.com.tw(境外基金適用)查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

0731-7 PGIMSITE202407219

保德信證券投資信託股份有限公司

台北總公司：110台北市信義區基隆路一段333號14樓

Tel：(02) 8726-4888

Fax：(02) 2763-8889

台中分公司：407台中市西屯區市政路402號5樓之5

Tel：(04) 2252-5818

Fax：(04) 2252-5808

高雄分公司：804高雄市鼓山區明誠三路679號5樓

Tel：(07) 586-7988

Fax：(07) 586-7688